

B772

产品说明书

规范修订历史：

版本	发行时间	新制/修订内容
V1.0	2020/03	新增
V1.1	2021/03	修改订单信息
V1.2	2024/02	更换新模板
V1.3	2025/03	增加应用注意事项以及整体排版
V1.4	2026/06	引脚排列

电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

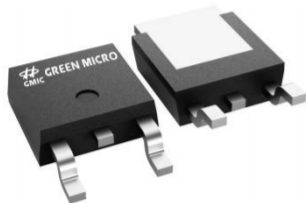
极限值(绝对最大额定值) ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V_{CBD}	-50	V
集电极电流	I_{C}	-3	A
集电极功耗	P_{C}	1.25	W
结温	T_{j}	150	$^{\circ}\text{C}$

电特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_{\text{C}}=-0.1\text{mA}, I_{\text{E}}=0$	-50			V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_{\text{C}}=-1\text{mA}, I_{\text{B}}=0$	-30			V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_{\text{E}}=-0.1\text{mA}, I_{\text{C}}=0$	-7			V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-30\text{V}, I_{\text{E}}=0$			-0.5	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-3\text{V}, I_{\text{C}}=0$			-0.5	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{\text{CE}}=-2\text{V}, I_{\text{C}}=-1\text{A}$	100		400	
集电极-发射极饱和电压	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=-2\text{A}, I_{\text{B}}=-200\text{mA}$			-0.5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{\text{BE(sat)}}$	$I_{\text{C}}=-2\text{A}, I_{\text{B}}=-200\text{mA}$			-2	V
特征频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=-5\text{V}, I_{\text{C}}=-0.1\text{A}, f=10\text{ MHz}$	50	80		MHz

产品外观

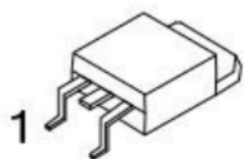


TO-252

订购信息

名称	封装	打印名称	包装	包装数量
B772GT	TO-252	B772 G249	编带	2500/盘

引脚排列

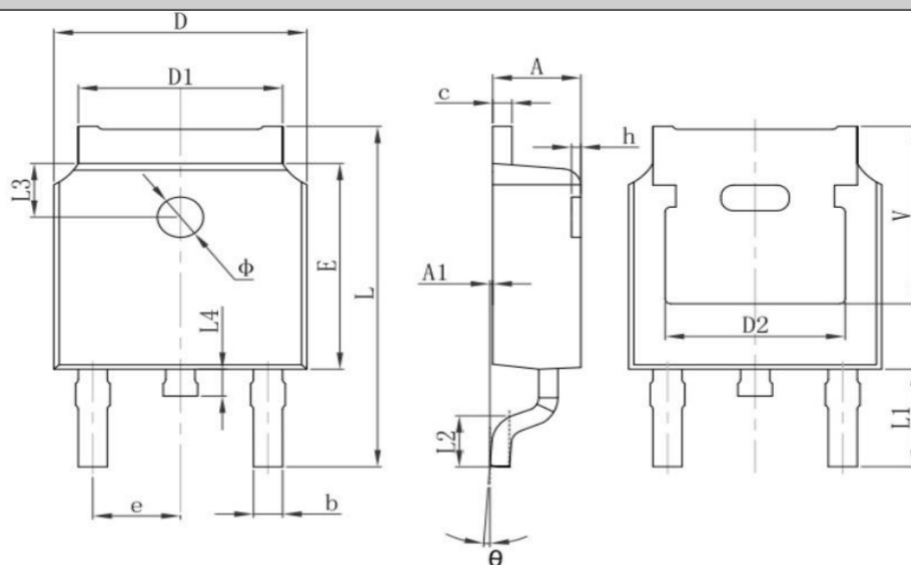


TO-252

	功能
1	Base
2	Collector
3	Emitter

封装外形图

TO-252



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.200	2.400	0.087	0.094
A1	0.000	0.127	0.000	0.005
b	0.660	0.860	0.026	0.034
C	0.460	0.580	0.018	0.023
D	6.500	6.700	0.256	0.264
D1	5.100	5.460	0.201	0.215
D2	4.830 REF.		0.190 REF.	
E	6.000	6.200	0.236	0.244
e	2.186	2.386	0.086	0.094
L	9.800	10.400	0.386	0.409
L1	2.900 REF.		0.114 REF.	
L2	1.400	1.700	0.055	0.067
L3	1.600 REF.		0.063 REF.	
L4	0.600	1.000	0.024	0.039
φ	1.100	1.300	0.043	0.051
θ	0°	8°	0°	8°
h	0.000	0.300	0.000	0.012
V	5.350 REF.		0.211 REF.	

重要声明

- 绿微芯片保留无通知更改产品及文档的权利，客户应在订货前获取并核实最新技术资料的完整性，同时，绿微芯片对非官方修订文件不承担任何 何责任或义务。
- 整份产品规格书中任何一项参数仅供参考，以实际应用测试为准；客户使用产品进行系统设计时，必须遵守安全规范并独立承担以下责任：按应用需求选择适配的绿微产品；完成应用的设计验证及全链路测试；确保应用符合目标市场安全法规或其他要求，因设计缺陷或违规操作导致的人身/财产损失，均由客户自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片产品禁止用于生命维持、军事装备、航天航空关键应用等场景。超范围使用引发的一切事故与法律责任，皆由使用方自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片的所有技术资源（含数据表、参考设计）均按“现状”提供，不保证无缺陷或泛用性，不做出任何明示或者暗示的担保。文档仅授权 用于本文件所述产品开发与研究，严禁非授权使用知识产权、公开复制和反向工程。违规使用所导致的索赔及损失，均由使用方承担，与绿微芯片无关。

